

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第4区分
 【発行日】令和7年2月7日(2025.2.7)

【国際公開番号】WO2023/233877
 【出願番号】特願2024-524244(P2024-524244)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/00(2006.01)

B 3 2 B 7/025(2019.01)

H 0 5 K 1/03(2006.01)

B 3 2 B 7/022(2019.01)

10

【F I】

B 3 2 B 27/00 B

B 3 2 B 7/025

H 0 5 K 1/03 6 1 0 H

H 0 5 K 1/03 6 3 0 D

B 3 2 B 7/022

【手続補正書】

【提出日】令和6年11月13日(2024.11.13)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

層Aと、前記層Aの少なくとも一方の面上に配置された層Bとを含み、
 前記層Aが、液晶ポリマーを含み、

前記層Aの160 における弾性率E_Aに対する、前記層Bの160 における弾性率E_Bの比率が 1.0×10^{-6} 以上であり、
 誘電正接が0.005以下である、フィルム。

30

【請求項2】

前記弾性率E_Bが0.1GPa以下である、請求項1に記載のフィルム。

【請求項3】

前記弾性率E_Aに対する前記弾性率E_Bの比率が0.1以下である、請求項1に記載のフィルム。

【請求項4】

前記層Bの平均厚みが15μm以下である、請求項1に記載のフィルム。

【請求項5】

前記層Aの融点が315 以上である、請求項1に記載のフィルム。

40

【請求項6】

前記層Aがポリオレフィンを含む、請求項1に記載のフィルム。

【請求項7】

前記ポリオレフィンの含有量が、前記層Aの全質量に対して、5質量%~30質量%である、請求項6に記載のフィルム。

【請求項8】

前記層Bが、ポリマーと反応性基を有する化合物とを含む組成物の硬化物を含む、請求項1に記載のフィルム。

【請求項9】

50

層 C をさらに含み、
前記層 C、前記層 A、及び前記層 B の順に配置されている、請求項 1 に記載のフィルム

【請求項 10】

前記層 C の平均厚みが $15 \mu\text{m}$ 以下である、請求項 9 に記載のフィルム。

【請求項 11】

前記層 C が、ポリマーと反応性基を有する化合物との硬化物を含む、請求項 9 に記載のフィルム。

【請求項 12】

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載のフィルムと、

前記フィルムの少なくとも一方の面上に配置された金属層と、を有する積層体。

10

【請求項 13】

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載のフィルムと、

前記フィルム的一方の面上に配置された金属配線と、

前記フィルムの他方の面上に配置された金属層と、を有する配線基板。

【請求項 14】

第 1 の金属層と、

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載の第 1 フィルムと、

金属配線と、

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載の第 2 フィルムと、

第 2 の金属層と、をこの順に有し、

前記金属配線が、前記第 1 フィルム及び前記第 2 フィルムの一部に埋設されている、積層配線基板。

20

【請求項 15】

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載の第 1 フィルムと、前記第 1 フィルム的一方の面上に配置された第 1 金属層と、を有する積層体を作製する工程と、

請求項 1 ~ 請求項 1.1 のいずれか 1 項に記載の第 2 フィルムと、前記第 2 フィルム的一方の面上に配置された金属配線と、前記第 2 フィルムの他方の面上に配置された第 2 金属層と、を有する配線基板を作製する工程と、

前記積層体と前記配線基板とを、前記第 1 金属層及び前記第 2 金属層がいずれも最表面

30

となるように重ね合わせ、熱圧着する工程と、
を含む積層配線基板の製造方法。

40

50